

Dow rilancia il Packaging Innovation Awards

Il concorso diventa biennale e per la prima volta la cerimonia di premiazione si terrà in Asia. C'è tempo fino a marzo per candidarsi.

10 ottobre 2023 08:36

Da una trentina d'anni Dow premia l'innovazione nell'imballaggio attraverso il concorso Packaging Innovation Awards, giunto quest'anno alla sua trentacinquesima edizione.

Per la prima volta, la cerimonia di premiazione non si terrà negli Stati Uniti ma in Giappone, a Tokyo, nell'ottobre dell'anno prossimo. Da questa edizione, inoltre, il premio assume una cadenza biennale.

I tre pilasti del concorso dedicato agli imballaggi sono progresso tecnologico, sostenibilità e miglioramento dell'esperienza utente. Non è necessario utilizzare materiali forniti da Dow e l'iscrizione è gratuita. È però richiesto che i packaging siano sul mercato da almeno sei mesi alla data di scadenza delle iscrizioni, fissata per l'8 marzo 2024.

Finalisti e vincitori saranno selezionati da una giuria indipendente, composta da professionisti dell'industria dell'imballaggio ed esperti di sostenibilità. La proclamazione dei progetti giunti alla fase finale avverrà il 28 agosto 2024.

L'edizione del 2022 aveva raccolto oltre 180 candidature di packaging da 30 paesi, 28 delle quali ritenute meritevoli di un riconoscimento ([qui i vincitori](#)).

Per informazioni e iscrizioni: [Packaging Innovation Awards](#)

© Polimerica - Riproduzione riservata

